

3D Wirebonder

Der erste um die Ecke Drahtbonder

Programm / Ausschreibung	IWI 24/26, IWI 24/26, Basisprogramm Ausschreibung 2025	Status	laufend
Projektstart	04.03.2025	Projektende	03.09.2026
Zeitraum	2025 - 2026	Projektlaufzeit	19 Monate
Keywords			

Projektbeschreibung

Das Ziel dieses Innovationsprojekts ist es einen funktionsfähigen 3D Wirebonder für Dünndrahtapplikationen zu entwickeln. Dafür soll zusätzlich zu den bestehenden Verfahrensmöglichkeiten eine weitere Rotations- und Verkippsachse des Bauteilhalters realisiert und alle miteinander synchronisiert werden.

Projektpartner

- F&S BONDTEC Semiconductor GmbH